

2025 年 6 月 9 日

独立行政法人日本学生支援機構が発行する
「ソーシャルボンド」への投資について

長野三菱電機機器販売株式会社（代表取締役社長 折井義尚、以下「当社」という）は、このたび、独立行政法人日本学生支援機構（以下、「同機構」という）が発行するソーシャルボンド（第 79 回日本学生支援債券、以下「本債券」という）に投資しましたので、お知らせします。

「ソーシャルボンド」とは、社会的課題の解決に資するプロジェクト（ソーシャルプロジェクト）の資金調達のために発行される債券のことであり、本債券の発行による調達資金は、同機構が担う奨学金事業の内、貸与奨学金の財源として活用されるものです。

奨学金制度は、「教育の機会均等」や、国連の持続可能な開発目標（SDGs）の内、目標 4「すべての人に包摂的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する。」に資するものであり、社会貢献の一環として今回の投資を決定いたしました。

当社は本債券を始めとしたグリーンボンド・ソーシャルボンドへの投資を継続的に実施することで、今後も社会的責任を果たして参ります。日本学生支援債券への投資は2023年に続く2回目の投資となります。

【本債券の概要】

銘 柄	第 79 回日本学生支援債券
年 限	2 年
発 行 額	300 億円
発 行 日	2025 年 6 月 9 日

以上